澜起科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023年11月6日)

证券简称: 澜起科技 证券代码: 688008 编号: 2023-027

投资者关系活动类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(电话会议)
参与单位名称	长盛基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 长江证券股份有限公司 平安证券股份有限公司
时间	2023年11月3日
地点	上海
公司接待人员姓名	公司董事会秘书: 傅晓 其他接待人员: 梁铂钴、孔旭、邓扬帆
投资者关系活动主要内容介绍	(一)交流的主要问题及答复问题 1:请问如何看待公司明后年的成长逻辑?答复:公司明后年的成长逻辑主要可以从以下四个方面来看: 1、行业整体需求恢复:根据行业分析,服务器及计算机行业去库存已接近尾声,行业预期服务器需求将从明年开始恢复增长,进而带动公司相关产品的需求持续提升。 2、DDR5 持续渗透:明年将是 DDR5 渗透的重要时间节点,目前行业主流观点认为,DDR5 渗透率将在 2024 年年中超过 50%,到 2025 年将进一步提升。这将有助于公司 DDR5 相关产品销售收入在明后年持续增长。 3、DDR5 子代迭代加快: DDR5 内存接口芯片的子代迭代已正式开启,其迭代速度较 DDR4 世代明显加快。2023 年第三季度,公司 DDR5 第一子代 RCD 芯片需求量持续提升,第二子代 RCD 芯片开始规模出货,第三子代 RCD 芯片已于 10 月在业界率先试产,同时公司正积极开展DDR5 第四子代 RCD 芯片的工程研发。澜起牵头制定 DDR5 RCD 芯片国际标准,在该领域研发保持相对领先,子代迭代加快将有利于公司维系相关产品的平均销售单价和毛利率在较高水平。

4、新产品开始上量:从 2024 年开始,公司的几个新产品将逐步上量,包括 PCIe 5.0 Retimer 芯片、MRCD/MDB 芯片、MXC 芯片、CKD 芯片等。由于这些新产品都是澜起自研产品,均有望实现较高毛利率水平,同时,澜起在这些领域具有全球首发或全球领先的竞争优势,新产品的上量将对公司未来的业绩产生积极影响。

问题 2: 公司如何展望第四季度及明年服务器行业的需求变化情况?

答复:根据近期行业分析报告及龙头内存模组厂商最新财报中对行业未来的展望来看,认为明年除了AI服务器继续保持高速增长外,服务器总出货量也将恢复增长,服务器行业本轮去库存大概率在今年年底基本结束。

问题 3: 公司 DDR5 RCD 芯片各个子代目前出货情况分别如何? DDR5 第二子代 RCD 芯片的出货会继续提升吗?

答复: 2023 年第三季度,公司出货的 DDR5 RCD 芯片以第一子代产品为主,同时第二子代 RCD 芯片已有规模出货,且占比快速提升。根据主流 CPU 厂商公布的最新产品路线图,其下一代服务器 CPU 平台(支持DDR5 速率为 5600MT/S)将于 2023年 12 月发布,预计 DDR5 第二子代 RCD 芯片的需求将在明年进一步提升。

问题4:请问公司的内存接口芯片是否支持ARM架构的CPU?如果CPU厂商市场份额如果发生变化,会不会导致内存接口芯片的竞争格局发生变化?

答复:内存接口芯片和内存模组配套芯片的直接客户是内存模组厂商,不是CPU厂商。公司的内存接口芯片符合JEDEC组织标准,可支持包括 X86架构、ARM架构在内的符合JEDEC标准的服务器CPU。所以,内存接口芯片的竞争格局并不会因为CPU厂商的份额变化而发生重大变化。

问题 5: 公司 DDR5 内存接口芯片还保持领先的市场地位吗?

答复:公司保持着在内存接口芯片领域的相对领先态势。公司牵头制定 DDR5 RCD 及 MDB 芯片的国际标准,研发持续领先。近两年,公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD 芯片、第三子代 RCD 芯片,目前正在开展 DDR5 第四子代 RCD 芯片的工程研发,公司有信心在未来继续巩固该领域的相对领先地位。

问题 6:公司的研发费用在今年前三季度依然保持快速增长,半年报也显示公司的研发团队还在不断扩充,请问主要原因是什么?未来的研发人员、研发费用的趋势如何?

答复:公司2023年前三季度研发费用为4.87亿元,同比增长50.39%,研发费用增长主要是由于公司加大研发投入,研发人员薪酬、工程费用、协作开发费等费用较上年同期有较大增长。截至2023年6月末研发技术人员515人,较2022年底增加47人。后续,公司将根据业务发展规划、研发项目进度、公司盈利及资金情况,合理安排研发费用投入。

问题 7: 请问 MRCD/MDB 芯片预计从什么时候开始上量?哪些终端用户会最先使用这个产品?

答复: AI 及大数据应用的发展以及相关技术的演进推动服务器 CPU 的内核数量快速增加,迫切需要大幅提高内存系统的带宽,以满足多核 CPU 中各个内核的数据吞吐要求,服务器高带宽内存模组 MRDIMM 正是基于这种应用需求而产生。

MRDIMM 中文名称为多路合并阵列双列直插内存模组,是一种更高带宽的内存模组,采用了 DDR5 LRDIMM "1+10" 的基础架构,需要搭配 1 颗 MRCD 芯片及 10 颗 MDB 芯片。与 RDIMM 相比,MRDIMM 可以同时访问内存模组上的两个阵列,提供双倍带宽,第一代产品预计支持 8800MT/s 速率。

MRCD/MDB 用于 MRDIMM,相较于同时期的内存接口芯片,其设计更为复杂、支持速率更高,价值量将有所提升。根据行业分析,由于MRDIMM 采用了"1颗 MRCD+10颗 MDB"的架构,随着其未来渗透率的提升,将带动 MRCD/MDB(特别是 MDB)芯片需求大幅增长。

根据某主流服务器 CPU 厂家最新产品路线图, 其支持 MRDIMM 的服务器 CPU 平台计划于明年下半年发布, 因此, 用于 MRDIMM 的 MRCD/MDB 芯片有望从明年开始逐步上量。

从目前观察到的情况来看,由于 MRDIMM 将在未来高性能数据中心中起到重要作用,头部云计算或互联网厂商对其表示了密切的关注和兴趣。

问题 8: 如何展望 PCIe Retimer 芯片需求量? 和竞争对手相比,公司的产品都有哪些优势?

答复: 随着 AI 服务器需求快速增长,将显著提升 PCIe Retimer 芯片的需求。以一台典型的配 8 块 GPU 的主流 AI 服务器为例,考虑对信号完整性和传输速率的要求,系统需要配置 8 颗乃至 16 颗 PCIe Retimer 芯片;如果是搭配 16 块 GPU 的主流 AI 服务器,需要配置的 PCIe Retimer 芯片会相应增加。根据行业分析,PCIe 5.0 Retimer 芯片的市场规模较 PCIe 4.0 有望明显增长,同时,出于供应安全的考虑,客户一般会选择 2-3 家 PCIe 5.0 Retimer 芯片供应商来供货。

作为全球领先的 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片供应商之一,公司自研的 PCIe SerDes IP 已成功应用于该产品中,自研 IP 带来了良好的整合性,在产品的时延、信道适应能力方面,公司具有一定的优势。

问题 9: 公司新产品 CKD 芯片预计什么时候开始上量?

答复: CKD 芯片是 JEDEC 定义的标准化产品,当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时,台式机及笔记本电脑的 UDIMM、SODIMM 内存模组,须采用一颗专用的时钟驱动芯片(CKD 芯片)。根据某主流 CPU厂家最新产品路线图,其支持 DDR5 6400MT/s 的客户端 CPU 平台预计明年上市,因此,公司的 CKD 芯片预计明年下半年开始上量。

是否涉及应披 露重大信息的

无

说明	
附件清单(如有)	无